



致冷晶片 Thermoelectric Cooling Chip

产品特性 Features

- 体积小、轻量化
Small bulk and light weight
- 无动件、低噪音
No vibration and noise-free
- 精确控温
Precise temperature control
- 可靠度高
High reliability

产品应用端 Application:

适用于极端环境 Rugged environment durable

广泛用于冰箱、饮水机、医疗 / 军用仪器和实验科学仪器等，需要温度反覆变化的热循环 (Thermal Cycle) 应用情境。此外，致冷晶片也已大量导入于半导体晶圆的制程温度控制上。

It's widely used in medical equipment, freezer, drinking fountains, military petroleum instruments as these applications need thermal cycling control. Besides, it's also widely being applied to control the temperature during fabrication of semiconductor.

产品物性 Properties

Size(mm)	Height(mm)	I _{max} (A)	V _{max} (V)	Watt(W)	最大致冷量 @27° C Q _{max} (W)	最大致冷量 @50° C Q _{max} (W)	R(Ohm)
15×15	3.1	6.0	3.8	22.8	13	14.3	0.45±10%
	3.4	8.5	2.1	17.9	10.3	11.3	0.20±10%
	3.6	3.9	3.8	14.8	8.6	9.5	0.85±10%
	3.8	3.0	3.8	11.4	7.3	8	1.00±10%
	3.9	6.0	2.1	12.6	7.4	8.2	0.30±10%
	4.7	2.0	3.8	7.6	4.4	5	1.65±10%
20×20	3.1	6.0	8.8	52.8	29.7	32.7	1.05±10%
	3.4	8.5	3.8	32.3	18.8	20.8	0.35±10%
	3.6	3.9	8.8	34.3	18.7	20.9	1.95±10%
	3.8	3.0	8.8	26.4	16.6	18	2.20±10%
	3.9	6.0	3.8	22.8	13.6	14.9	0.55±10%
	4.7	2.0	8.8	17.6	10.2	11.2	3.70±10%
30×30	3.15	6.0	15.7	94.2	53.1	59.1	1.90±10%
	3.45	8.5	8.8	74.8	43.1	48	0.85±10%
	3.65	3.9	15.7	61.2	35.2	39	3.50±10%
	3.85	3.0	15.7	47.1	29.8	32.5	4.00±10%
	3.95	6.0	8.8	52.8	31.1	34.2	1.25±10%
	3.95	6.0	11.8	70.8	48	52.8	1.65±10%
	4.75	2.0	15.7	31.4	18.2	19.5	6.70±10%
40×40	3.45	8.5	15.7	133.5	77.1	85	1.50±10%
	3.95	6.0	15.7	94.2	55.6	61	2.20±10%

► For special sizes, please contact our product consultants.

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan
T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version19
20230721



注意：本技术数据表内的资讯是根据高柏团队的研究与测试得出的最佳数据。本技术数据表中列出的值仅代表典型值，并非对每一批生产的物料都进行测试。所有规格如有变更，恕不另行通知；无影响产品功能之保护膜及离型纸，如非特殊要求，皆依高柏默认为准。由于各种可能的使用条件超出了我们的控制范围，因此我们提出的所有建议均不构成保证或责任，用户应自行进行测试，以确定我们的产品在任何特定情况下的适用性。本产品的销售没有任何明示或暗示的说明，表示其适用于特定目的或其他用途的保证，但本产品应依据高柏与您确认的发票、报价、或订单，提供最标准的产品质量。我们不承担使用者如何延伸或改变此技术数据表中的资讯，使用者应承担所有风险。此外，本技术数据表中的资讯不包含任何内容解释与涉及产品材料的现有用途、未来专利冲突、工艺制造，与使用产品的建议。